smiths interconnect

L Series

Rugged High Density Modular Connectors



Hyperboloid Technology

Smiths Interconnect는 표준 및 맞춤형 솔루션에 적합한 광범위한 접합 기술을 제공합니다. Hypertac®은 신뢰성과 안전성이 중요시되는 열악한 조건에서 사용하도록 설계된 우수한 하이퍼볼로이드 접합 기술입니다. Hypertac® 하이포볼로이드 접합 기술의 고유한 전기적, 기계적 특성을 통해 신뢰성, 결합 주기, 낮은 접합력 및 최소 접촉 저항 측면에서 매우 우수한 성능을 보장합니다. 접합부 슬리브는 쌍곡선

모양으로 배열된 접합 와이어로 형성되며 핀 주변의 접합 라인으로 탄력적으로

정렬되어 다수의 선형 접합 경로를 제공합니다.



낮은 삽입력/인출력

소켓 와이어 각도를 통해 핀의 삽입력 및 인출력을 엄격하게 제어할 수 있습니다. 스프링 와이어는 유연하게 구부러져 핀과 선형 접합합니다.

긴 접합 수명

부드럽고 가벼운 와이핑 작업을 통해 접촉면의 마모를 최소화합니다. 성능 저하는 최소화하면서 최대 100,000회의 삽입/인출 주기를 수행할 수 있습니다.

낮은 접촉 저항성

Hypertac 설계는 보다 넓은 접합 영역을 제공하며 와이어의 와이핑 동작을 통해 깨끗한 접합 표면을 보장합니다. 당사의 접합 기술은

기존 접합 설계 저항성의 절반 정도입니다.

높은 정격 전류

접합부의 설계 매개변수(예: 와이어의 수, 직경 및 각도)는 모든 요구 사항에 맞추어 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 접합 영역이 더 넓은 표면으로 분산되도록 와이어의 수를 늘릴 수 있습니다. 즉, 인접한 라인 접합으로 인해 각 와이어를 통해 전달되는 고전류는 여러 번 증가할 수 있습니다.

충격 및 진동 저항성

와이어의 낮은 질량과 이로 인한 낮은 관성을 통해 접촉 손실 없이 핀의 갑작스러운 또는 극단적인 편위를 수용할 수 있습니다. 접합 영역은 핀 주변으로 360° 확장되며 이는 전체 길이에 걸쳐 균일합니다. Hypertac 접합 설계의 3차원 대칭은 모든 상황에서의 전기적 연속성을 보장합니다.

이점

고밀도 상호 연결 시스템

하위 시스템 설계의 크기와 무게를 크게 줄일 수 있습니다. 결합 및 분리 강도를 이겨내기 위한 추가적인 장치가 필요하지 않습니다.

낮은 유지 비용

Hypertac 접합 기술은 대부분의 제품 요구 사항을 충족하므로 커넥터 또는 전체 하위 시스템 교체에 대한 부담과 비용을 절감할 수 있습니다.

저전력 소비량

Hypertac 기술의 낮은 접촉 저항성으로 인해 커넥터 전체의 전압 강하가 줄어들기 때문에 시스템 내 전력 소비량과 열 발생량이 감소합니다.

최대 접합부 성능

Hypertac 접합부의 낮은 접촉 저항성은 열 축적을 감소시킵니다. 이를 통해 불리한 고온 영향 없이 더 작은 접합부 어셈블리에서 더 큰 전류를 처리할 수 있습니다.

가혹한 조건에서의 신뢰성

열악한 환경에서는 충격 및 진동 등의 까다로운 조건에서도 전기적 무결성을 유지할 수 있는 커넥터가 필요합니다. Hypertac 의 접합 기술은 이러한 까다로운 조건에서도 어떠한 고장 없이 매우 우수한 안정성을 제공합니다.

목차

L 시리즈	4	
기능 및 이점	4	
주문 방법		
Frames:		
Frame A	6	
Frame B	7	
Frame BV	8	
Frame H	9	
Frame J	10	
Frame JV	11	
Frame MV	12	
Frame MY	13	
Madulas'		
Modules:		
Technical Characteristics	1	4
		4
Technical Characteristics	15	.4
Technical Characteristics	15 16	.4
Technical Characteristics	15 16 17	.4
Technical Characteristics		.4
Technical Characteristics Accessories Module A Module R Module B		.4
Technical Characteristics Accessories Module A Module R Module B Module S		.4
Technical Characteristics Accessories Module A Module R Module B Module S Module C & M		.4
Technical Characteristics Accessories Module A Module R Module B Module S Module C & M Module U		.4
Technical Characteristics Accessories Module A Module R Module B Module S Module C & M Module U Module D		.4
Technical Characteristics Accessories Module A Module R Module B Module S Module C & M Module U Module D Module W		.4
Technical Characteristics Accessories Module A Module R Module B Module S Module C & M Module U Module D Module W Module V		.4
Technical Characteristics Accessories Module A Module R Module B Module S Module C & M Module U Module D Module W Module V Module V Coax		.4

L Series Connectors



Smiths Interconnect L 시리즈의 견고한 고밀도 모듈식 커넥터는 빌딩 블록 원리에 기반한 DIY 시스템을 사용합니다. L 시리즈 시스템은 모듈 및 프레임의 두 가지 요소로 구성됩니다. 다양한 방식 및 접합 유형의 모듈(신호, 전원 및 동축 유형 포함)을 단일 커넥터 프레임 내 맞춤형 배열로 결합할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 상용 부품으로 특정 요구 사항에 부합하는 커넥터를 구축할 수 있습니다.

견고한 랙 및 패널 분야에 적합한 L 시리즈 커넥터는 Hypertac®의 우수한 하이포볼로이드 접합 기술을 통해 긴 수명 주기, 낮은 삽입력/인출력 및 충격/진동 저항성을 제공합니다. 이를 통해 다수의 접합부가 있는 커넥터에서 최대 성능으로 원활하고 쉬운 결합이 가능합니다.

접합부는 소형 플라스틱 블록에 장착되며 용이한 조립 및 수리을 위해 제거될 수도 있습니다. 모듈을 제자리에 고정시키는 프레임은 2개의 측면 레일 및 말단 캡으로만 구성된 기본 프레임부터 잭스크류, 후드 및 케이블 클램프로 구성된 보다 복잡한 프레임까지 다양합니다. 대부분의 모듈 조합과 부합하기 위해 모든 프레임이 다양한 길이로 제공됩니다. L 시리즈를통해 특수 설계된 커넥터를 신속하고 저렴하게 구입할 수 있으므로 맞춤형 공구 세공이 필요하지 않습니다.

Features and Benefits

낮은 삽입력/인출력

고밀도 상호 연결 시스템

가혹한 조건에서의 신뢰성

- 충격 및 진동에 대한 내성
- 긴 접합 수명
- 최소 접촉 저항성
- 저전력 소비량

높은 정격 정류

낮은 유지 비용

설계 유연성

- 금속 백쉘/플라스틱 후드
- 커넥터 프레임 내 맞춤형 모듈 조합으로 구성된 빌딩 블록 시스템
- 신호, 전원 및 동축 접합 유형의 가용성
- 고정 및 스냅인(snap-in) 버전
- 신속한 반회전 분리용 잭스크류

패널 및 랙, 패널 적용 분야에 케이블 연결

고정 접합부

모듈	접합부	전류
유형 A	5	8 A
유형 B	3	15 A
유형 C	2	25 A
유형 D	17	8 A
유형 M	2	50 A

스냅인 압착 접합부

모듈	접합부	전류
유형 G	1	200 A
유형 K	1	100 A
유형 R	5	8 A
유형 S	3	15 A
유형 U	2	25 & 50 A
유형 V	3	25 A
유형 V	3 동축	_
유형 W	30	4 A

How To Order



		/		SC	
1 2 3	5	5	6	7	8
1 L 시리즈 [고정] ¹					
2 절연체	P 플러그 E 리셉터클				
3 프레임 유형	A 프레임 A B 프레임 B J 프레임 J J V 프레임 JV	BV 프레임 BV MV 프레임 MV	H 프레임 H MY 프레임 MY		
4 프레임 길이	4 단위.20공 ⁽²⁾ 프레임 길이는 모듈 단위에 모듈 수량을 곱히 잭스크류가 있는 프레임의 경우 2개의 추가?		합니다.		
5 모듈 수량 + 부품 번호	4 + AMST / 2 + CHT 프레임 내 동일한 모듈 수량 (모듈 부품 번호 모듈 부품 번호는 14 페이지 참조). 예시: 4, 각 모듈 시리즈는 "/"로 구분합니다. 모듈은	호의 시작 부분에서 "L" 삭제 AMST = (L)AMST 모듈에서	너 4개.		
6 도금	TG 니켈 위에 10 μin의 금 도급 TH 니켈 위에 20 μin의 금 도급 TAH 니켈 위에 50 μin의 금 도급	∃			
7 케이블클램프 및 사이즈 ⁽³⁾ (J & JV 프레임에만 해당)	S C 1 0 0.394 [10.00] 최대, 0.2 S C 2 0 0.787 [20.00] 최대, 0.0		S C 1 5 0.590 [15. S C 2 4 0.945 [24.	•	
8 케이블 클램프 위치	L 왼쪽 R 오른쪽 기본 위치는 생략합니다. (J/JV: 상단, K/KV	F 전면 √: 전면, MV/MY: 표시된 비	B 후면 :와 같음)		

참고: 1. 부품 번호가 24자 이상인 경우 주문 시 단축된 특수 부품 번호가 지정됩니다. 2. 프레임 MV 및 MY는 12, 15, 20 및 22 단위로만 제공됩니다. 3. 길이가 짧은 커넥터에서는 케이블 클램프 크기에 일부 제한이 있을 수 있습니다.

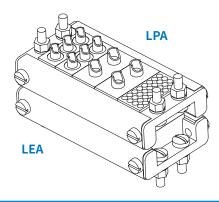


Frames

Dimensions and Specifications

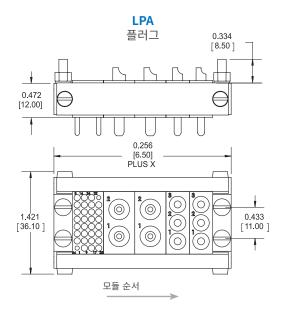
Frame A

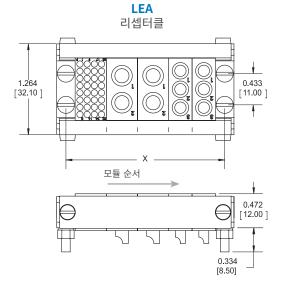
단순한 랙 및 패널



단위	Х	플러그	리셉터클
4	1.122 [28.50]	LPA4	LEA4
5	1.338 [34.00]	LPA5	LEA5
6	1.555 [39.50]	LPA6	LEA6
7	1.771 [45.00]	LPA7	LEA7
8	1.988 [50.50]	LPA8	LEA8
9	2.205 [56.00]	LPA9	LEA9
10	2.421 [61.50]	LPA10	LEA10
11	2.638 [67.00]	LPA11	LEA11
12	2.854 [72.50]	LPA12	LEA12
13	3.070 [78.00]	LPA13	LEA13
14	3.287 [83.50]	LPA14	LEA14
15	3.504 [89.00]	LPA15	LEA15
16	3.720 [94.50]	LPA16	LEA16
17	3.936 [100.00]	LPA17	LEA17
18	4.153 [105.50]	LPA18	LEA18
19	4.370 [111.00]	LPA19	LEA19
20	4.586 [116.50]	LPA20	LEA20

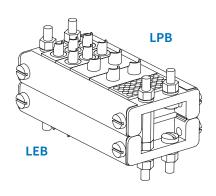
무게 (모듈 제외)	
플러그 A	4 단위에서 1.0 oz. 20 단위에서 1.9 oz.
리셉터클 A	4 단위에서 1.0 oz. 20 단위에서 1.9 oz.





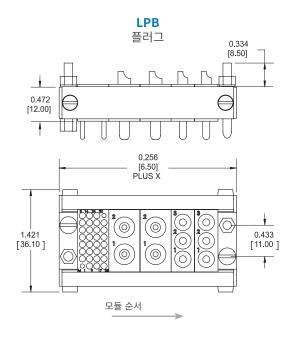
Frame B

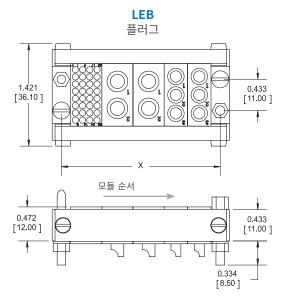
가이드가 있는 단순한 랙 및 패널



단위	Х	플러그	리셉터클
4	1.122 [28.50]	LPB4	LEB4
5	1.338 [34.00]	LPB5	LEB5
6	1.555 [39.50]	LPB6	LEB6
7	1.771 [45.00]	LPB7	LEB7
8	1.988 [50.50]	LPB8	LEB8
9	2.205 [56.00]	LPB9	LEB9
10	2.421 [61.50]	LPB10	LEB10
11	2.638 [67.00]	LPB11	LEB11
12	2.854 [72.50]	LPB12	LEB12
13	3.070 [78.00]	LPB13	LEB13
14	3.287 [83.50]	LPB14	LEB14
15	3.504 [89.00]	LPB15	LEB15
16	3.720 [94.50]	LPB16	LEB16
17	3.936 [100.00]	LPB17	LEB17
18	4.153 [105.50]	LPB18	LEB18
19	4.370 [111.00]	LPB19	LEB19
20	4.586 [116.50]	LPB20	LEB20

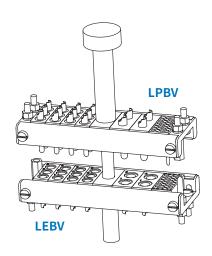
무게 (모듈 제외)	
플러그 B	4 단위에서 1.0 oz. 20 단위에서 1.9 oz.
리셉터클 B	4 단위에서 1.0 oz. 20 단위에서 1.9 oz.





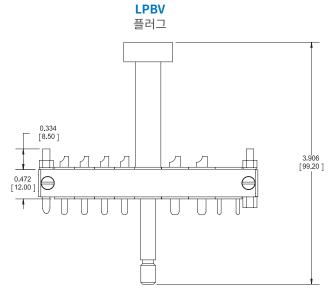
Frame BV

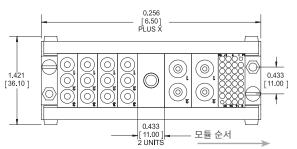
가이드 및 잭스크류가 있는 랙 및 패널

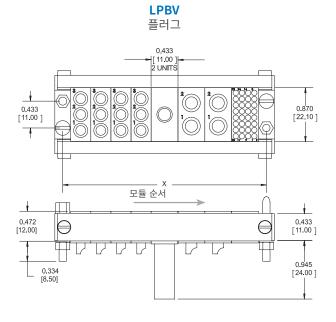


단위	Х	플러그	리셉터클
4	1.122 [28.50]	LPBV4	LEBV4
5	1.338 [34.00]	LPBV5	LEBV5
6	1.555 [39.50]	LPBV6	LEBV6
7	1.771 [45.00]	LPBV7	LEBV7
8	1.988 [50.50]	LPBV8	LEBV8
9	2.205 [56.00]	LPBV9	LEBV9
10	2.421 [61.50]	LPBV10	LEBV10
11	2.638 [67.00]	LPBV11	LEBV11
12	2.854 [72.50]	LPBV12	LEBV12
13	3.070 [78.00]	LPBV13	LEBV13
14	3.287 [83.50]	LPBV14	LEBV14
15	3.504 [89.00]	LPBV15	LEBV15
16	3.720 [94.50]	LPBV16	LEBV16
17	3.936 [100.00]	LPBV17	LEBV17
18	4.153 [105.50]	LPBV18	LEBV18
19	4.370 [111.00]	LPBV19	LEBV19
20	4.586 [116.50]	LPBV20	LEBV20

무게 (모듈 제외)	
플러그 BV	4 단위에서 4.7 oz. 20 단위에서 5.6 oz.
리셉터클 BV	4 단위에서 2.5 oz. 20 단위에서 3.4 oz.





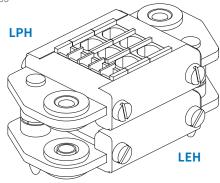


Frame H

가이드가 있는 랙 및 패널

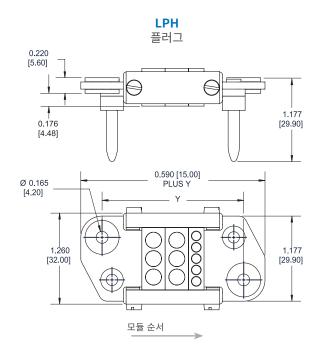
■ 중앙에서 최대 0.049 [1.25]¹의 플로트 마운팅

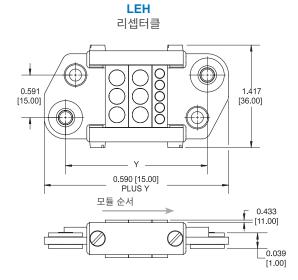
돼®파일 번호: UL E102195



단위	Υ	플러그	리셉터클
4	1.969 [50.00]	LPH4	LEH4
5	2.185 [55.50]	LPH5	LEH5
6	2.402 [61.00]	LPH6	LEH6
7	2.618 [66.50]	LPH7	LEH7
8	2.835 [72.00]	LPH8	LEH8
9	3.051 [77.50]	LPH9	LEH9
10	3.268 [83.00]	LPH10	LEH10
11	3.484 [88.50]	LPH11	LEH11
12	3.701 [94.00]	LPH12	LEH12
13	3.917 [99.50]	LPH13	LEH13
14	4.134 [105.00]	LPH14	LEH14
15	4.350 [110.50]	LPH15	LEH15
16	4.567 [116.00]	LPH16	LEH16
17	4.784 [121.50]	LPH17	LEH17
18	5.00 [127.00]	LPH18	LEH18
19	5.217 [132.50]	LPH19	LEH19
20	5.433 [138.00]	LPH20	LEH20
21	5.650 [143.50]	LPH21	LEH21
22	5.866 [149.00]	LPH22	LEH22

무게 (모듈 제외)	
플러그 H	4 단위에서 1.9 oz. 20 단위에서 2.8 oz.
리셉터클 H	4 단위에서 1.6 oz. 20 단위에서 2.5 oz.

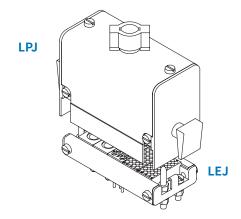


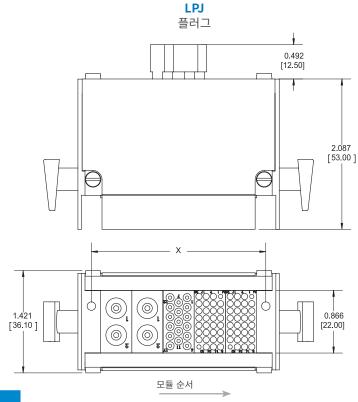


Frame J

금속 백쉘

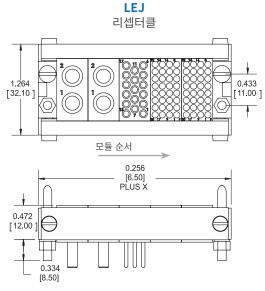
- 원형 케이블 클램프가 있는 후드형 커넥터
- 케이블 클램프의 대체 위치를 사용할 수 있습니다.





단위	х	플러그	리셉터클
4	1.122 [28.50]	LPJ4	LEJ4
5	1.338 [34.00]	LPJ5	LEJ5
6	1.555 [39.50]	LPJ6	LEJ6
7	1.771 [45.00]	LPJ7	LEJ7
8	1.988 [50.50]	LPJ8	LEJ8
9	2.205 [56.00]	LPJ9	LEJ9
10	2.421 [61.50]	LPJ10	LEJ10
11	2.638 [67.00]	LPJ11	LEJ11
12	2.854 [72.50]	LPJ12	LEJ12
13	3.070 [78.00]	LPJ13	LEJ13
14	3.287 [83.50]	LPJ14	LEJ14
15	3.504 [89.00]	LPJ15	LEJ15
16	3.720 [94.50]	LPJ16	LEJ16
17	3.936 [100.00]	LPJ17	LEJ17
18	4.153 [105.50]	LPJ18	LEJ18
19	4.370 [111.00]	LPJ19	LEJ19
20	4.586 [116.50]	LPJ20	LEJ20

-			
ī			



무게 (모듈 제외)	
플러그	4 단위에서 3.5 oz. 20 단위에서 5.5 oz.
리셉터클	4 단위에서 1.2 oz. 20 단위에서 2.1 oz.

참고: 1. 평평한 케이블 클램프가 있는 플러그를 사용할 수 있습니다. 이 경우 부품 번호를 J에서 K로 바꾸고 케이블 클램프의 콜아웃 (callout)을 SC33 [33mm] 또는 SC50 [50mm]로 바꿉니다. 2. 케이블 클램프가 없는 플러그를 사용할 수 있습니다. 이 경우 부품 번호를 J에서 R로 바꾸고 SC 케이블 클램프의 콜아웃을 제거합니다. 단위는 인치[mm]로 제공됩니다.

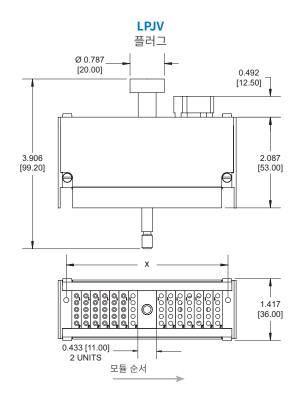
Frame JV

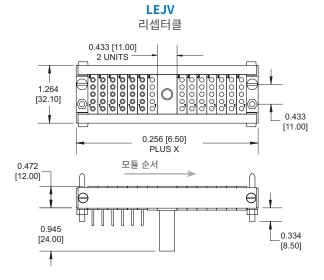
금속 백쉘

- 원형 케이블 클램프가 있는 후드형 커넥터
- 특별 주문을 통해 측면 및 이중 개구부 사용 가능
- 잭스크류 인출

단위	Х	플러그	리셉터클
4	1.122 [28.50]	LPJV4	LEJV4
5	1.338 [34.00]	LPJV5	LEJV5
6	1.555 [39.50]	LPJV6	LEJV6
7	1.771 [45.00]	LPJV7	LEJV7
8	1.988 [50.50]	LPJV8	LEJV8
9	2.205 [56.00]	LPJV9	LEJV9
10	2.421 [61.50]	LPJV10	LEJV10
11	2.638 [67.00]	LPJV11	LEJV11
12	2.854 [72.50]	LPJV12	LEJV12
13	3.070 [78.00]	LPJV13	LEJV13
14	3.287 [83.50]	LPJV14	LEJV14
15	3.504 [89.00]	LPJV15	LEJV15
16	3.720 [94.50]	LPJV16	LEJV16
17	3.936 [100.00]	LPJV17	LEJV17
18	4.153 [105.50]	LPJV18	LEJV18
19	4.370 [111.00]	LPJV19	LEJV19
20	4.586 [116.50]	LPJV20	LEJV20

무게 (모듈 제외)	
플러그	4 단위에서 1.0 oz. 20 단위에서 1.9 oz.
리셉터클	4 단위에서 1.0 oz. 20 단위에서 1.9 oz.





참고: 1. 평평한 케이블 클램프가 있는 플러그를 사용할 수 있습니다. 이 경우 부품 번호를 J에서 K로 바꾸고 케이블 클램프의 콜아웃(callout)을 SC33 [33mm] 또는 SC50 [50mm]로 바꿉니다. 2. 케이블 클램프가 없는 플러그를 사용할 수 있습니다. 이 경우 부품 번호를 J에서 R로 바꾸고 SC 케이블 클램프의 콜아웃을 제거합니다. 단위는 인치[mm]로 제공됩니다.

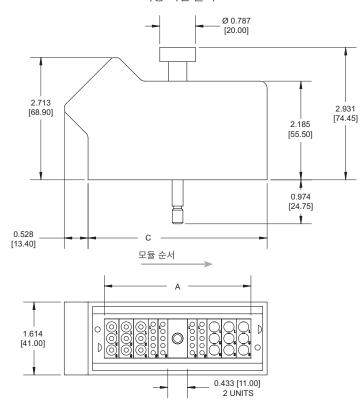
Frame MV

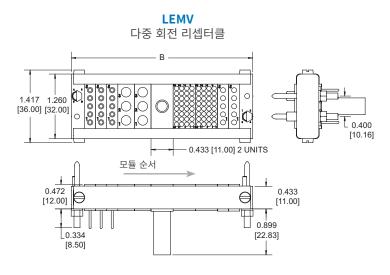
플라스틱 백쉴

- 180°의 표준 다중 회전
- 최대 300개의 신호 접합부
- 조정 가능한 케이블 클램프: 0.425~1.26 [11.50~32.00]
- 5,000회 이상의 결합 주기
- 36개 키잉 조합
- 견고한 검정 블랙카보네이트 백쉘
- 내장 핀 보호
- 12, 15, 20 및 22 단위 길이

단위 ⁽¹⁾	А	В	С	플러그	리셉터클
12	2.598 [66.00]	3.11 [79.00]	3.315 [84.20]	LPMV12	LEMV12
15	3.248 [82.50]	3.76 [95.50]	3.965 [100.70]	LPMV15	LEMV15
20	4.331 [110.00]	4.843 [123.00]	5.047 [128.20]	LPMV20	LEMV20
22	4.764 [121.00]	5.276 [134.00]	5.480 [139.20]	LPMV22	LEMV22

LPMV 다중 회전 플러그





참고: 1. 잭스크류가 있는 프레임의 경우 2개의 추가적인 단위가 허용됩니다. 단위는 인치[mm]로 제공됩니다.

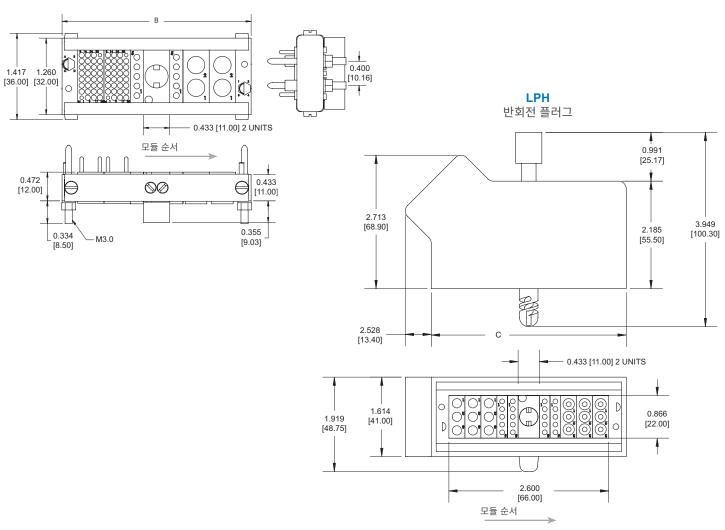
Frame MY

플라스틱 백쉴

- 180°의 신속한 회전
- 최대 300개의 신호 접합부
- 조정 가능한 케이블 클램프: 0.425 [11.50]~1.26 [32.00]
- 5,000회 이상의 결합 주기
- 36개 키잉 조합
- 견고한 검정 블랙카보네이트 백쉘
- 내장 핀 보호
- 12, 15, 20 및 22 단위 길이

단위 ⁽²⁾	В	С	플러그	리셉터클
12	3.11 [79.00]	3.312 [84.20]	LPMY12	LEMY12
15	3.76 [95.50]	3.965 [100.70]	LPMY15	LEMY15
20	4.843 [123.00]	5.047 [128.20]	LPMY20	LEMY20
22	5.276 [134.00]	5.480 [139.20]	LPMY22	LEMY22

LEH 반회전 리셉터클



참고: 1. LPMMY로 사용 가능한 후드가 없는 반회전 플러그 프레임. **2.** 잭스크류가 있는 프레임의 경우 2개의 추가적인 단위가 허용됩니다.

단위는 인치[mm]로 제공됩니다.

Modules

Specifications and Ordering Information

Technical Characteristics

	Α	В	С	D	G	K	M	R	S	U	V ⁽¹⁾	w
정격 전류	8 A	15 A	25 A	8 A	200 A	100 A	50 A	8 A	15 A	25/50 A	25 A ⁽²⁾	4 A
접촉 저항성 (mΩ)	< 2.5	< 1.0	< 0.8	< 3.0	< 0.2	<0.35	< 0.4	< 2.5	< 1.5	< 0.8	< 1.5	< 5.0
인출력 (oz.) (접합부당)	1.0~ 5.0	3.0~ 25.0	4.0~ 32.0	1.0~ 4.5	80.0~ 160.0	15.0~ 90.0	4.0~ 40.0	1.0~ 5.0	3.0~ 28.3	4.0~ 35.0	3.0~ 17.0	0.5~ 2.0
접합 수명 주기						> 100	0,000					
파괴 전압 (V RMS)	> 2,000	> 1,600	> 3,000	> 1,800	> 1,500	> 1,500	> 3,000	> 1,600	> 2,000	> 2,800	> 1,600	>2,200
DWV (V RMS)	1,500	1,200	2,250	1,350	1,100	1,100	2,250	1,200	1,500	2,100	1,200	1,650
절연 저항성 (500 VDC에서 MΩ)	10 ⁶	10 ⁴	104	104	104	10 ⁹						
정격 온도 (°C)	-55~125	-55~125	-55~125	-55~125	_	_	-55~125	-55~125	-55~125	-55~105	-55~125	-55~125

대략적인 무게

핀 (oz.)	0.2	0.35	0.44	0.31	_	_	0.44	0.22	0.23	0.45	0.32	_
소켓(oz.)	0.15	0.25	0.31	0.45	_	_	0.31	0.16	0.35	0.29	0.34	_

소재

핀	황동 구리 황동								
소켓		베릴륨 구리선 및 황동 본체							
절연체	디알릴프탈레이트	폴리프탈레이트	디알릴프탈레이트	나일론	폴리 페닐렌 설파이드				

접합부 도금

핀 (니켈 위에 μin의 금 도금(최소))	10/50	30	10/50	
소켓	접합면: 니켈 위	에 50 μin의 금 도금(최	소) 단자: 니켈 위에 금 플래시 도금	

참고: 1. 모듈 V 동축 버전 사용 사능(23 페이지 참조) 2. 25 A (자유 대기) 17 A (번들)

Module Accessories

	압착 도구	압착 다이 세트	압착 포지셔너	삽입 도구	인출 도구	마운팅 브래킷
모듈 R						
유형 1 유형 2 유형 3 유형 4 유형 5	AF8	-	TP1650 TBA TP592 TP1128 TP613	\$0150.01	S0150.01	-
모듈 S						
모든 유형	M309	_	TP1179	S0250.01	S0250.01	_
모듈 U						
유형 1 유형 2 유형 3 유형 4 유형 5	T1264 T1264 T1264 T712 T1264	_ _ _ T761 _	TP1232 TP1232 TP1232 T758 T1559	\$0350.01	S0350.01	_
모듈 W						
모든 유형	AFM8	_	K547 (유형 R만 해당) K547-2 (유형 RR만 해당)	T1866	S/DEM1.0060	_
모듈 V						
모든 유형	M309	_	T1981	_	T1982	_
모듈 V 동축						
중앙 전선 외부 전선	AFM8 HX3	_ RG316DB용 T1958 또는 T2019	T1957 —	_	T1982	_
모듈 G						
모든 유형	T1501	_	T1536		T1500	T1551
모듈 K						
모든 유형	T1501	_	T1535	_	T1507	T1551

Module A

8 A의 접점정격

1 단위, 5개의 Hypertac® 하이포볼로이드 고정 접합부, Ø 0.059~[1.50] R 압착 모듈과 결합

知®파일 번호: UL E102195

모듈	젠더	단자	도금	부품 번호
Ø 0.079 [2.00] O.D. Ø 0.063 [1.60] I.D. PPPP 0.177 [4.50]	암	솔더컵 최대 16 AWG	50 µin의 금	LAFSTAH
Ø 0.039 [1.00] [8.80]	암	직선형 딥 솔더	50 µin의 금	LAFDTAH
0.630 [16.00] 0.157 [4.00] 0.209 0.866 [22.00] 0.512 [13.00] 0.982 [24.95]	빈 블록	_	_	LAHT (ZLM005-001)
Ø 0.059 [1.50] 0.256 [6.50]	수	솔더컵	10 μin의 금	LAMST
Ø 0.079 [2.00] O.D.	T	최대 16 AWG	50 µin의 금	LAMSTH
Ø 0.059 [1.50] 0.256 [6.50]	수	직선형 딥 솔더	10 µin의 금	LAMDT
Ø 0.039 [1.00]	T	역산성 답 출니	50 µin의 금	LAMDTH

Module R

8 A의 접점정격

1 단위, 5개의 Hypertac® 하이포볼로이드 "스냅인" 압착 접합부, Ø 0.059~[1.50] 자체적으로 또는 프레임에 장착 가능 A 모듈과 결합

뭐®파일 번호: UL E102195

모듈	젠더	와이어 게이지	I.D.	O.D.	도금	부품 번호	교체 접합부
		18-22	0.057 [1.45]	0.104 [2.65]	50 µin의 금	LRF1	YSK015-013AH
OD — ID		22-26	0.035 [0.90]	0.051 [1.30]	50 µin의 금	LRF2	YSK015-142AH
0.280 [7.10] MAX.	암	16	0.071 [1.80]	0.108 [2.75]	50 µin의 금	LRF3	YSK015-014AH
LRF		14	0.079 [2.00]	0.122 [3.10]	50 µin의 금	LRF4	YSK015-045AH
		28	0.022 [0.56]	0.076 [1.93]	50 µin의 금	LRF5	YSK015-009AH
0.630 [16.00] 0.217 [5.50] 0.157 [4.00] 0.866 [22.00] 0.522 [13.25] 0.906 [23.00] 1.140 [28.95]	빈 블록	_	_	_	_	LRH (ZLR005-001)	_
		18-22	0.057	0.104	10 µin의 금	LRM1	YPN015-009RG
		10 22	[1.45]	[1.45] [2.65]	50 µin의 금	LRM1H	YPN015-009RH
Ø 0.058 [1.48] - 0.291 [7.40]		22-26	0.035	0.051	10 µin의 금	LRM2	YPN015-129G
		22-20	[0.90]	[1.30]	50 µin의 금	LRM2H	YPN015-129H
	수	1.0	0.071	0.108	10 µin의 금	LRM3	YPN015-010G
D - 11 0.213	T	16	[1.80]	[2.75]	50 µin의 금	LRM3H	YPN015-010H
OD 0.213			0.079	0.122	10 µin의 금	LRM4	YPN015-033RG
LRM			[2.00]	[3.10]	50 µin의 금	LRM4H	YPN015-033RH
		20	0.022	0.076	10 µin의 금	LRM5	YPN015-004RG
		28	[0.56]	[1.93]	50 µin의 금	LRM5H	YPN015-004RH

Module B

15 A의 접점정격

1.5 단위, 3개의 Hypertac® 하이포볼로이드 고정 접합부, Ø 0.098 [2.50] S 압착 모듈과 결합

知®파일 번호: UL E102195

모듈	젠더	단자	도금	부품 번호
Ø 0.138 [3.50] O.D. Ø 0.102 [2.60] I.D. 0.177 [4.50]	암	솔더컵 최대 12 AWG	50 µin의 금	LBFSTAH
Ø 0.098 [2.50] 0.354 [9.00]	암	직선형 딥 솔더	50 μin의 금	LBFDTAH
0.512 [13.00] 0.315 [8.00] 0.512 [13.00] 0.512 [13.00] 0.512 [13.00]	빈 블록	_	_	LBHT (ZLM003-001)
Ø 0.097 [2.47]		솔더컵	10 μin의 금	LBMST
0.256 [6.50]	수	최대 12 AWG	50 μin의 금	LBMSTH
Ø 0.097 [2.47] 0.256 [6.50]		지서형 디 소디	10 μin의 금	LBMDT
Ø 0.098 [2.50] 0.354 [9.00]	수	직선형 딥 솔더	50 µin의 금	LBMDTH

Module S

15 A의 접점정격

1.5 단위, 3개의 Hypertac $^\circ$ 하이포볼로이드 "스냅인" 압착 접합부, Ø 0.098 [2.50] 자체적으로 또는 프레임에 장착 가능 B 모듈과 결합

위 * 파일 번호: UL E102195

모듈	젠더	와이어 게이지	I.D.	O.D.	도금	부품 번호	교체 접합부
ID — OD		16-22	0.059 [1.50]	0.122 [3.10]	50 µin의 금	LSF1	YSK025-003AH
0.315 (S.00)	암	14-16	0.077 [1.95]	0.122 [3.10]	50 µin의 금	LSF2	YSK025-004AH
LSF		12	0.100 [2.54]	0.150 [3.81]	50 µin의 금	LSF4	YSK025-013AH
0.512 (13.00] 0.256 (6.50] 0.866 (22.00] 0.522 (13.25] 0.522 (13.25] 0.866 (22.00]	빈 블록	_	_	_	_	LSH (ZLS003-002)	_
Ø 0.097 0.295 [7.50]		16-22	0.059	0.122	10 µin의 금	LSM1	YPN025-002G
		16-22	[1.50]	[3.10]	50 µin의 금	LSM1H	YPN025-002H
	수	14-16	0.077	0.122	10 µin의 금	LSM2	YPN025-003G
	干	14-16	[1.95]	[3.10]	50 µin의 금	LSM2H	YPN025-003H
ID OD 0.315 [8.00]		12	0.100	0.150	10 µin의 금	LSM4	YPN025-011RG
LSM		12	[2.54]	[3.81]	50 µin의 금	LSM4H	YPN025-011RH

Modules C & M

25 또는 50 A의 접점정격

2 단위, 2개의 Hypertac® 하이포볼로이드 고정 접합부, Ø 0.138~[3.50] U 압착 모듈과 결합

위®파일 번호: UL E102195

모듈	젠더	단자	도급	정격 전류	부품 번호			
$C = \emptyset$ 0.177 [4.50] $M = \emptyset$ 0.193 [4.90] — $C = \emptyset$ 0.138 [3.50] $M = \emptyset$ 0.177 [4.50]	암	솔더컵 최대 10 AWG	50 Ol 7	25 A	LCFSTAH			
0.177 [4.50] LCF/LMF	2	솔더컵 최대 8 AWG	50 μin의 금	50 A	LMFSTAH			
Ø 0.138 [3.50] 0.352 [8.95]	암	직선형 딥	50 µin의 금	25 A	LCFDTAH			
LCF/LMF		솔더	30 μπ= =	50 A	LMFDTAH			
0.374 [9.50] 0.425 [10.80] 0.512 [13.00] 0.980 [24.90] LCHT	빈 블록	_	_	_	LCHT (ZLM002-001)			
C = 0.256 (6.50) M = 0.335 (8.50) Ø 0.137 [3.48]		솔더컵	10 µin의 금	25 A	LCMST			
	_	수	_	_	최대 10 AWG	50 µin의 금	25 A	LCMSTH
C=Ø 0.138 [3.50] M=Ø 0.177 [4.50] C=Ø 0.177 [4.50]	ı	수 솔더컵	10 µin의 금	50.4	LMMST			
M=Ø 0.193 [4.90]		최대 8 AWG	50 µin의 금	50 A	LMMSTH			
Ø 0.137			10 μin의 금	25.4	LCMDT			
0.354		직선형 딥	50 µin의 금	25 A	LCMDTH			
Ø 0.138 [3.50]	수	<u>솔</u> 더	10 μin의 금	FO A	LMMDT			
LCM/LMM			50 µin의 금	50 A	LMMDTH			

Module U

25 또는 50 A의 접점정격

2 단위, 2개의 Hypertac® 하이포볼로이드 "스냅인" 압착 접합부, Ø 0.138~[3.50] C 및 M 압착 모듈과 결합

知®파일 번호: UL E102195

고 (1995년 - 1995년 - 19 - 1995년 - 199 - 1995년 - 199	젠더	와이어 게이지	I.D.	O.D.	도금	정격 전류	부품 번호	교체 접합부					
		20-22	0.059 [1.50]	0.122 [3.10]	50 µin의 금	25 A	LUF1	YSK035-009AH					
ID OD		16-18	0.077 [1.95]	0.122 [3.10]	50 µin의 금	25 A	LUF2	YSK035-010AH					
0.266 [6.75]	암	12-14	0.112 [2.85]	0.161 [4.10]	50 µin의 금	25 A	LUF3	YSK035-011AH					
LUF		6	0.217 [5.50]	0.285 [7.25]	50 µin의 금	50 A	LUF4	YSK035-030AH					
		8-10	0.177 [4.50]	0.217 [5.50]	50 µin의 금	50 A	LUF5	YSK035-028AH					
0.374 [9.50] 0.431 [10.95] 0.431	빈 블록	_	_	_	_	_	LUH (ZLU002- 001)	_					
		20-22		0.122	10 µin의 금	25 A	LUM1	YPN035-005G					
		20 22		[1.50]	[1.50]	[1.50]	[1.50]	[1.50]	[1.50]	[3.10]	50 µin의 금	25 A	LUM1H
0.295 Ø 0.137		16-18	0.059	0.122	10 µin의 금	25 A	LUM2	YPN035-006G					
Ø 0.137 [3.48] [7.50]		10 10	[1.50]	[3.10]	50 µin의 금	25 A	LUM2H	YPN035-006H					
	수	12-14	0.112	0.161	10 µin의 금	25 A	LUM3	YPN035-007G					
` <u>`</u>		12-14	[2.85]	[2.85]	[2.85] [4.10]	50 µin의 금	25 A	LUM3H	YPN035-007H				
OD 0.266 [6.75]		6	0.217	0.285	10 µin의 금	50 A	LUM4	YPN035-025RG					
LUM		6	[5.50]	[7.25]	50 µin의 금	SU A	LUM4H	YPN035-025RH					
		0_10	0.177	0.217	10 µin의 금	50 A	LUM5	YPN035-023RG					
		0 10	8-10 [4.50]			[5.50]	50 µin의 금	30 A	LUM5H	YPN035-023RH			

Module D

8 A의 접점정격

2 단위, 17개의 Hypertac® 하이포볼로이드 고정 접합부, Ø 0.147 [1.20]

知®파일 번호: UL E102195

모듈	젠더	단자	도금	부품 번호
0.051 [1.60] 0.051 [1.30]	암	솔더컵 최대 20 AWG	50 µin의 금	LDFSTAH
Ø 0.047 [1.19] 0.354 [9.00]	암	직선형 딥 솔더	50 µin의 금	LDFDTAH
0.118 [3.00] 0.236 [6.00] 0.423 [10.75]	빈 블록 수	_	_	LDMHT (ZLM017-001)
0.118 [3.00]	빈 블록 암	_	_	LDFHT (ZLM017-002)
Ø 0.046 [1.17] 0.256 [6.50]		솔더컵	10 μin의 금	LDMST
ID Ø 0.051 [1.30] 0.177 0.177 [4.50]	수	최대 20 AWG	50 µin의 금	LDMSTH
Ø 0.046 [1.17] 0.256 [6.50]		지사형 디 소디	10 μin의 금	LDMDT
Ø 0.047 [1.19] - - 0.354 [9.00]	수	직선형 딥 솔더	50 µin의 금	LDMDTH

참고: 1. 모듈을 프레임에 조립하는 경우 모듈당 2개의 YHD0027 클립이 필요합니다. 단위는 인치[mm]로 제공됩니다.

Module W

4 A의 접점정격

2 단위, 30개의 Hypertac° 하이포볼로이드의 제거 가능한 접합부, Ø 0.024~[0.60] 자체적으로 또는 프레임에 장착 가능

모듈	젠더	단자	I.D.	O.D.	도금	부품 번호	교체 접합부
SOLDER CUP CRIMP I.D O.D O.D		압착 18-20 AWG	0.055 [1.39]	0.071 [1.80]	50 µin의 금	LWFRRTAH	YSK006-089AH
	암	압착 22-26 AWG	0.035 [0.90]	0.051 [1.30]	50 µin의 금	LWFRTAH	YSK006-011ANH
LWF 1 및 32 위치의 가이드 구멍.		솔더컵 26 AWG	0.039 [1.00]	0.057 [1.45]	50 µin의 금	LWFSTAH	YSK006-010ANH
0.982 [24.95] 0.512 [13.00] 0.864 [21.95] 0.100 [2.54] 0.423 [10.75] 0.100 [2.54]	암 빈 블록	_	_	_	_	LWFHT (ZLM030-002)	_
0.700 [17.78] 0.100 [2.54] 0.423 [10.75] 0.100 [2.54] 0.260 [6.60] 0.512 [13.00] 0.982 [24.95]	수 빈 블록	_	_	_	_	LWMHT	_
		압착 18-20 AWG	0.055 [1.39]	0.071 [1.80]	10 μin의 금	LWMRRT	YPN006-158G
					50 µin의 금 10 µin의 금	LWMRRTH	YPN006-158H YPN006-021G
	수	압착 22-26 AWG	0.035 [0.90]	0.051 [1.30]	50 µin의 금	LWMRTH	YPN006-021H
LD LD		_			10 µin의 금	LWMST	YPN006-020G
O.D ' \ O.D ' \ LWM 1 및 32 위치의 가이드 구멍.		솔더컵 26 AWG	0.039 [1.00]	0.057 [1.45]	50 µin의 금	LWMSTH	YPN006-020H

Module V

25 A의 접점정격

 $1.5~\rm CH, 3$ 개의 $\rm Hypertac^{\circ}$ 하이포볼로이드 고정 접합부 자체적으로 또는 프레임에 장착 가능

뭐®파일 번호: UL E102195

모듈	젠더	단자	부품 번호	교체 접합부
0.439 [11.15]	암	압착 12-14 AWG	LVFP1TAH	YSK025-031AH
0.276 [7.00] (8.25) (8.25) (8.25) (8.25) (8.25) (8.25) (8.25) (9.00) (9.00) (1.140) (1	암 빈 블록		LVFHT (ZLV003-001)	_
0.906 [23.00]	수 빈 블록	—	LVMHT (ZLV003-002)	_
0.294 [7.47] 0.122 [3.11]	수	압착 12-14 AWG	LVMP1TH	YPN025-024H

Module V

Coax

1.5 단위, 13개의 Hypertac $^{\circ}$ 하이포볼로이드 접합부(신호 및 접지 접합부 모두) 자체적으로 또는 프레임에 장착 가능

위 * 파일 번호: UL E102195

모듈	젠더	단자	부품 번호	교체 접합부
0.441 [11.20]	O.L	동축 압착 RG316용	LVFRTAH	YCX0315-002AH
LVF	암	동축 압착 RG316DB용	LVFR1TAH	YCX0315-019AH
0.201 [5.10]	암	동축 솔더 RG405 또는 T-Flex 405용	LVFSTAH	YCX0315-001AH
0.129		동축 압착 RG316용	LVMTH	YCX0315-004H
0.129 [3.27]	수	동축 압착 RG316DB용	LVMR1TH	YCX0315-018H
0.291 (7.38)	수	압착 12-14 AWG	LVMSTH	YCX0315-003H

케이블 연결	압착부 (R) 및 (R1)	솔더 (S)
케이블	RG316 & RG316DB	RG405 & T-Flex 405
소켓	4 단위에서 1.6 oz. 20 단위에서 2.5 oz.	S50301 & S50307
핀	S50304	S50303 & S50308

고객서비스부서를 통해 사양을 요청할 수 있습니다.

COAXTAC™

공칭 임피던스	50 Ω
주파수 범위	RG316와 DC 3 GHz
	RG405와 DC 18 GHz
접촉 저항성	
내부 접합부	8 mΩ(최대)
외부 접합부	2 mΩ(최대)
정격 온도	-55°~125° C
전압 정상파 비율	(DC~3 GHz) 1:20:1 (최대)
	(3 GHz~18 GHz) 1:50:1 (최대)
RF 전송 손실	18 GHz에서 0.50 dB
절연 저항성	5,000 MΩ(최소)
DWV	500 V RMS
접합부당 인출력	1.5~6.0 oz.(최대). 3.0 oz.(평균)
커넥터 수명 주기	25,000회 주기 이상

소재 및 마감재

소재	황동, 베릴륨동 PTFE 플로로카본
마감재	
중앙 접합부 및 하우징 와이어	니켈, 구리 위에 금 니켈 위에 금

Module G

200 A의 접점정격

3.5 단위, 1개의 Hypertac $^{\circ}$ 하이포볼로이드의 제거 가능한 압착 접합부, Ø 0.239 [6.08] LEH 및 LPH 프레임에서만 권장됨

위 * 파일 번호: UL E102195

모듈	젠더	단자	I.D.	도금	부품 번호	교체 접합부
2.354 [59.80]	암	압착 1/0 AWG	0.445 [11.30]	50 µin의 금	LGFRTAH	YSK0612-015AH
0.994 [25.25] 0.756 [19.20] 0.864 [21.95]	수	압착 1/0 AWG	0.445 [11.30]	30 µin의 금	LGMRTI	YPN0612-021RI

Module K

100 A의 접점정격

2.5 단위, 1개의 Hypertac° 하이포볼로이드의 제거 가능한 압착 접합부, Ø 0.169 [4.30] LEH 및 LPH 프레임에서만 권장됨

위시®파일 번호: UL E102195

모듈	젠더	단자	I.D.	도금	부품 번호	교체 접합부
1.922 [48.83]	암	압착 4 AWG	0.283 [7.20]	50 μin의 금	LKFRTAH	YSK043-010AH
0.795 [20.20] 0.864 [21.95] 0.864 [21.95]	수	압착 4 AWG	0.283 [7.20]	30 μin의 금	LKMRTI	YPN043-010AH

Mounting Dimensions

단위	х	Υ		
4	1.122 [28.50]	1.969 [50.00]		
5	1.338 [34.00]	2.185 [55.50]		
6	1.555 [39.50]	2.402 [61.00]		
7	1.771 [45.00]	2.618 [66.50]		
8	1.988 [50.50]	2.835 [72.00]		
9	2.205 [56.00]	3.051 [77.50]		
10	2.421 [61.50]	3.268 [83.00]		
11	2.638 [67.00]	3.484 [88.50]		
12	2.854 [72.50]	3.701 [94.00]		
13	3.070 [78.00]	3.917 [99.50]		
14	3.287 [83.50]	4.134 [105.00]		
15	3.504 [89.00]	4.350 [110.50]		
16	3.720 [94.50]	4.567 [116.00]		
17	3.936 [100.00]	4.784 [121.50]		
18	4.153 [105.50]	5.00 [127.00]		
19	4.370 [111.00]	5.217 [132.50]		
20	4.586 [116.50]	5.433 [138.00]		
21	4.803 [122.00]	5.650 (143.50)		
22	5.019 [127.50]	5.866 (149.00)		

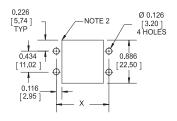
Stationary Mounting

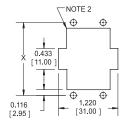
프레임 유형: A, B, BV, J, JV, K, KV, R, RV

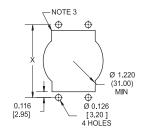
커넥터의 와이어 측면에 장착

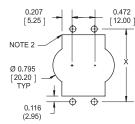
잭스크류가 제거되는 고정식 장착

잭스크류의 홀다운 클램프용 공간을 제공하기 위한 리셉터클의 3가지 대체 마운팅 규격





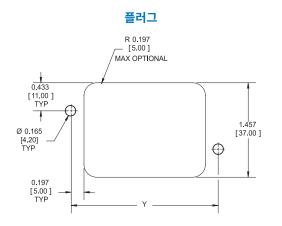


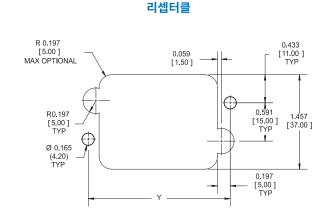


참고: 1. 표준 프레임의 경우 선택한 모듈이 장착된 상태로 조립되어 배송됩니다. **2.** 59.0 oz.의 마운팅 토크. **3.** 0.010 [0.25]의 최대 반경. 단위는 인치[mm]로 제공됩니다.

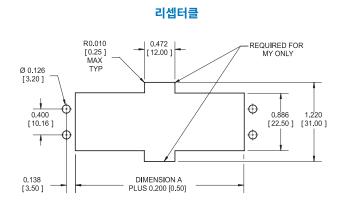
Float Mounting

H 유형의 프레임용





Mounting MV & My유형의 프레임용



단위	А
12	2.598 [66.00]
15	3.248 [82.50]
20	4.331 [110.00]
22	4.764 [121.00]

참고: 1. 표준 프레임의 경우 선택한 모듈이 장착된 상태로 조립되어 배송됩니다. 2. 59.0 oz.의 마운팅 토크. 3. 0.010 [0.25]의 최대 반경. 단위는 인치[mm]로 제공됩니다.

전세계 지원

커넥터

미국

판매

connectors.uscsr@smithsinterconnect.com

기술적 지원

connectors.ustechsupport@smithsinterconnect.com

유럽

판매

connectors. emeacsr@smiths interconnect.com

기술적 지원

connectors.emeatechsupport@smithsinterconnect.com

아시아

판매

asiacsr@smithsinterconnect.com

기술적 지원

asiatechsupport@smithsinterconnect.com

광섬유 및 RF 부품

미국

판매

focom.uscsr@smithsinterconnect.com

기술적 지원

focom.techsupport@smithsinterconnect.com

focom.emeacsr@smithsinterconnect.com

focom.techsupport@smithsinterconnect.com

아시아

focom.asiacsr@smithsinterconnect.com

기술적 지원

focom.techsupport@smithsinterconnect.com

반도체 테스트

미국

판매

semi.uscsr@smithsinterconnect.com

기술적 지원

semi.techsupport@smithsinterconnect.com

유럽

판매

semi.emeacsr@smithsinterconnect.com

기술적 지원

semi.techsupport@smithsinterconnect.com

아시아

판매

semi.asiacsr@smithsinterconnect.com

기술적 지원

semi.techsupport@smithsinterconnect.com

RF/MW 하위 시스템

미국, 유럽 및 아시아

판매

subsystems.csr@smithsinterconnect.com

기술적 지원

subsystems.techsupport@smithsinterconnect.com

